



Toshiba stellt Bridge-ICs mit unterschiedlichen Display-Schnittstellen für IVI-Systeme in Fahrzeugen vor

Neue Bausteine beheben das Problem inkompatibler Schnittstellen bei neuen Displays

Düsseldorf, 2. Juni 2020 – Toshiba Electronics Europe („Toshiba“) erweitert sein Angebot für IVI-Systeme in Fahrzeugen (In-Vehicle Infotainment) um zwei neue Bridge-ICs mit unterschiedlichen Display-Schnittstellen.

Da IVI-Systeme immer komplexer und funktionsreicher werden, nimmt die Zahl integrierter Displays in modernen Fahrzeugen erheblich zu. Die unterschiedlichen Displays weisen häufig mehrere verschiedene Schnittstellenstandards (LVDS etc.) auf. Aufgrund inkompatibler Standards zwischen SoC und Display können nun einige bestehende Systeme die neuen Protokolle nicht unterstützen, z.B. Display Serial Interface (DSI) und embedded DisplayPort (eDP).

Um dieses Problem zu beheben, kommen Bridge-ICs wie der neue TC9594XBG und TC9595XBG von Toshiba zum Einsatz.

Der TC9594XBG unterstützt einen parallelen Eingang (24Bit @166MHz) und bietet einen 4-Lane x1-Kanal-MIPI®-DSI-TX-Ausgang. Der TC9595XBG kann zwei Eingangsarten verarbeiten: 4-Lane x1-Kanal-MIPI® DSI oder MIPI® DPI (24Bit @154MHz) und gibt VESA® DisplayPort™ 1.1a aus.

Beide Bausteine bieten WUXGA-Auflösung (1900 x 1200 @24Bit) und werden im VFBGA80-Gehäuse mit den Abmessungen 7mm x 7mm und 0,65mm Rastermaß ausgeliefert. Der TC9594XBG arbeitet im Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105°C; der TC9595XBG von -40 bis +85°C.

Toshiba verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von MIPI®-Schnittstellen-Bridge-ICs für den Consumer-Bereich. Die neuen Bausteine TC9594XBG und TC9595XBG erweitern das Angebot in den Automotive-Bereich und lösen Probleme mit inkompatiblen Schnittstellen, insbesondere in IVI-Systemen.

Muster des neuen TC9594XBG sind seit Mai 2020 erhältlich. Die Bemusterung des TC9595XBG ist ebenfalls noch in diesem Jahr geplant.

Weitere Informationen zu den neuen Display-Interface Bridge-ICs von Toshiba unter:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/interface-bridge-ics-for-mobile-peripheral-devices/display-interface-bridge-ics/detail.TC9594XBG.html>

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/interface-bridge-ics-for-mobile-peripheral-devices/display-interface-bridge-ics/detail.TC9595XBG.html>

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: solution-marketing@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0) 1932 822 832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Juni 2020

Ref. 7274A_GER